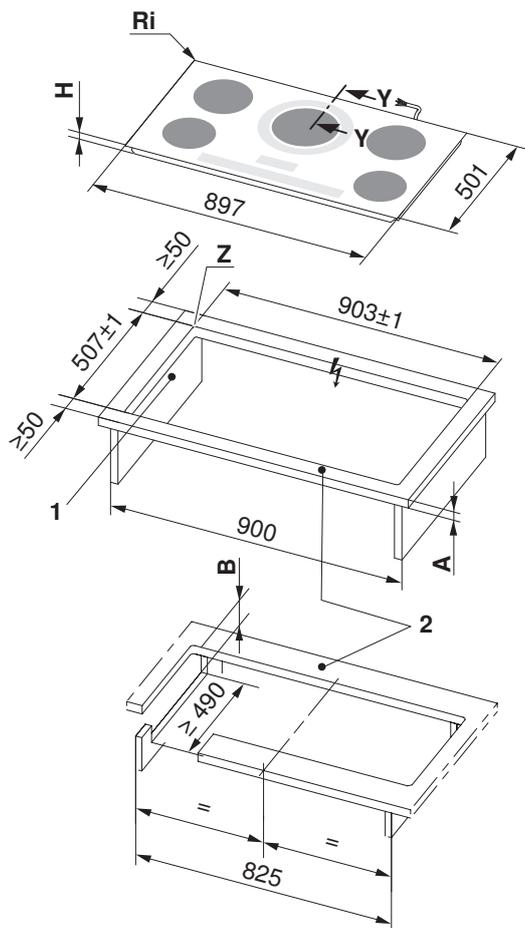
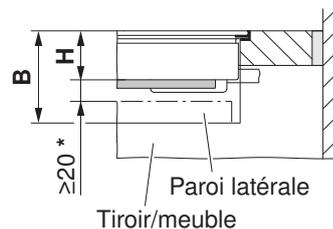


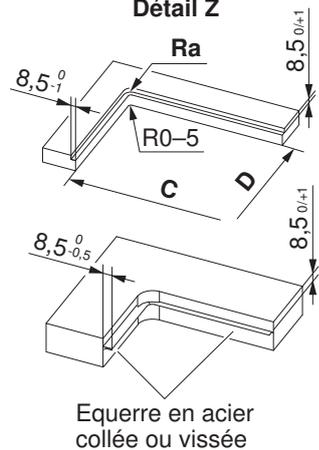
GK55TESF



Y - Y



Détail Z



\* Espace libre recommandé

- 1 En cas d'encastrement symétrique, il n'est pas nécessaire de découper les parois latérales.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du revêtement en pierre. La largeur minimale du bord peut varier selon les caractéristiques de la pierre.

Type	A au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
GK55TESF	≥30 mm	≥90 mm	886/490 mm	53,3 mm	5/1,5 mm

- A** Epaisseur du plan de travail (en combinaison avec un four installé directement dessous)
- B** Découpe dans les parois latérales (avec/sans kit de bouclier thermique)
- H** Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de l'auge du champ de cuisson
- Ri** Rayons d'angle de l'appareil
- Ra** Rayons d'angle extérieurs de la découpe